**芯机遇，实现芯梦想**

**——兆易创新2018校园招聘**

**芯团队**

**北京兆易创新科技股份有限公司**（简称“兆易创新”，沪市股票代码603986），成立于2005年4月，是一家**以中国为总部的全球化芯片设计公司**。

公司致力于各类存储器（SPI NOR FLASH®、SPI NAND FLASHTM）、控制器（GD32TM MCU）以及eMMC的设计研发，研发人员比例占全员比例60%以上，在中国大陆（北京/合肥/西安/上海/深圳）、香港、台湾、韩国、美国、日本、英国等多个国家和地区设有分支机构，营销网络遍布全球，并与多家世界知名晶圆厂、封装测试厂结成战略合作伙伴关系，为客户提供优质便捷的本地化支持服务。

**公司核心管理团队**由来自世界各地的高级管理人员组成，每位都曾在硅谷、韩国等著名IC企业工作多年，有着丰富的研发及管理经验。公司总裁兼CEO**朱一明**先生是国家“千人计划”的入选者，被授予国家级“特聘专家”荣誉称号。他领导下的兆易创新被授予“‘中国芯’最佳市场表现奖”、“重大科技成果产业化突出贡献单位”、“创新型试点企业”、“中国十强最具成长性半导体企业”等多项荣誉称号。

**公司现有员工**400余人，85%以上研发人员来自211或985高校。我们广纳雄心勃勃的专业人员和高级人才，提供包括**年底双薪、年终绩效奖金、五险一金、补充医疗保险、商业意外保险、各类补贴、免费健康体检、带薪假期、节日礼品、新生儿礼金**等有竞争力的薪资福利待遇。除此之外，公司还注重员工自身价值的提升，不遗余力组织**各类培训项目**，与员工共享公司成长硕果。

**上市信息：**沪市主板上市的第一家存储器芯片设计公司

**行业地位：**

* + SPI NOR Flash代码闪存领域顶尖的Fabless供应商；国内本领域的**龙头企业**
	+ **全球首家**推出8-Pin SPI NAND Flash闪存产品
	+ 中国高性能通用MCU领域的**领跑者**
	+ 中国**大陆首家**推出**ARM® Cortex®-M3/M4**内核通用MCU产品
	+ 中国串行闪存行业标准的**发起者**与**起草者**

**全球研发中心**：美国硅谷、中国北京、合肥、西安、上海

**全球销售支持网络**：北京、上海、深圳、合肥、西安、香港、台湾、美国、英国、韩国、日本

**公司总部**：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座12层

其他各地分支机构地址欢迎查阅公司网站[www.gigadevice.com](http://www.gigadevice.com)

**芯福利**

****

**欢迎关注兆易创新招聘微信号，获得最新鲜的招聘资讯！扫描二维码，或微信搜索 “兆易创新招聘”。**



**芯机遇**

**欢迎加入兆易！**

**★ 网申地址：** job.gigadevice.com或将简历投递至weiwei.wu@gigadevice.com

**★ 只能投递一个职位哦~，**投递简历过程中，如有任何疑问，欢迎随时联系campusfaq@gigadevice.com，我们将尽快为您解决。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **招聘岗位** | **人数** | **学历** | **专业** | **工作地** |
| **数字电路设计/验证工程师** | 10 | 硕士及以上 | 微电子/电子/电路等相关专业 | 北京/苏州 |
| **模拟集成电路设计工程师** | 8 | 硕士及以上 | 微电子/电子/电路等相关专业 | 北京 |
| **IC版图设计工程师** | 14 | 本科及以上 | 微电子/电子/电路等相关专业 | 北京/合肥/西安 |
| **IC测试工程师** | 15 | 本科及以上 | 测控/自动化/计算机/通信/微电子等相关专业 | 合肥 |
| **系统开发工程师** | 15 | 本科及以上 | 电子类相关专业 | 合肥 |
| **FAE技术支持工程师** | 6 | 本科及以上 | 电子/通讯/自动化等相关专业 | 深圳/合肥 |
| **产品工程师** | 5 | 本科及以上 | 电子/微电子等相关专业 | 合肥 |
| **嵌入式软件/应用工程师** | 21 | 硕士及以上 | 计算机/电子工程/通信/自动化相关专业 | 北京/西安/苏州 |
| **后端设计工程师（P&R）** | 6 | 硕士及以上 | 微电子/电子/电路等相关专业 | 北京/西安 |
| **射频集成电路设计工程师** | 9 | 硕士及以上 | 通信/微电子/微波等相关专业 | 北京/西安/苏州 |
| **无线网络物理层工程师** | 3 | 硕士及以上 | 通信/电子等相关专业 | 苏州 |

**具体职位要求如下：**

**数字电路设计/验证工程师（工作地：北京/苏州）**

岗位职责：

参与Flash产品，相关Controller和IP研发，负责逻辑设计与产品功能验证（Flash BU）；或基于ARM架构的高性能/低功耗SoC项目研发（MCU BU）

任职要求：

1.微电子/电子相关专业，硕士及以上学历

2.有深厚的数字专业知识，熟练掌握数字电路设计和验证方法学

3.有实际项目经验，精通Verilog，System Verilog，TCL，PERL等语言

4.熟悉低功耗设计

5.有较强动手能力和抗压能力

6.正直诚信、有责任心和团队合作精神

**模拟集成电路设计工程师（工作地：北京）**

岗位职责：

负责芯片的模拟电路设计和仿真

任职要求：

1.微电子等相关专业，硕士及以上学历

2.熟练使用HSPICE、HSIM等仿真工具

3.有ADC/DAC/LDO/PLL 经验者优先

4.诚信正直，踏实努力，具有较强的抗压能力

5.具有良好的沟通能力、学习能力、分析能力和团队合作能力

**IC版图设计工程师（工作地：北京/合肥/西安）**

岗位职责：

负责版图设计工作

任职要求：

1.微电子、电子工程相关专业，本科以上学历

2.熟悉模拟版图设计，有一定的模拟电路基础

3.熟悉virtuoso，熟练使用calibre进行DRC、LVS检查

4.有PLL/ADC/DAC/BGR等模拟模块版图设计经验优先考虑

5.熟悉SKILL/perl/TCL等编程语言优先考虑

6.有大型芯片模块整合工作经验优先考虑

7.有65nm以下工艺经验优先考虑

8.诚信正直，踏实努力，具有较强的抗压能力

9.具有良好的沟通能力、学习能力、分析能力和团队合作能力

**IC测试工程师（工作地：合肥）**

岗位职责：

1.新产品功能验证性测试开发，参数特性测试开发

2.测试设备和制具开发、使用维护

3.产品测试良率异常分析，不良品分析，电性失效分析，失效模式研究

4.量产测试（CP&FT）流程和测试程式建立、完善与维护

任职要求：

1.测控/自动化/计算机/通信/微电子等相关专业，本科及硕士学历，参加过电子类竞赛者优先

2.熟悉C、C++等高级编程语言

3.熟悉常用测试设备使用方法及原理

4.具有板级电路系统设计经验者优先

5.了解IC制造生产流程优先

**系统开发工程师（工作地：合肥）**

岗位职责：

1. 基于公司MCU芯片方案的研发和维护

2. MCU固件、应用程序编写

3. MCU性能、功能测试，以及接口电路设计、调试

4. 编写MCU技术文档

5. 客户应用方案的审阅与除错支持

任职要求：

1.本科及以上学历，电子类相关专业

2.熟悉电路设计及调试

3.熟悉C语言，有较好的编程习惯

4.具备嵌入式芯片如51单片机、ARM等系统设计项目经验

5.诚信正直，踏实努力，具有较强的团队合作意识和抗压能力

**FAE技术支持工程师（工作地：深圳/合肥）**

岗位职责：

负责MCU方面的技术支持，包括：

1.协助Sales前期产品推广阶段的技术支持

2.处理客户研发和生产阶段的技术问题，如：软硬件修改测试，产线异常处理等

3.与质量部门、研发部门一起处理客户端RMA

任职要求：

1.电子/通讯/自动化等相关专业，本科及以上学历

2.熟悉Cortex M3 系列MCU

3.有MCU系统方面软硬件设计的项目经验优先

4.良好的沟通交流能力、团队合作能力，善于处理客户抱怨

5.能适应短期出差

**产品工程师（工作地：合肥）**

岗位职责：

负责Flash产品开发，以及产品管理工作

1.新产品功能验证，参数特性测试验证

2.产品的可靠性评估

3.量产维护，不良品电性分析与良率改善

4.收集市场需求，与测试、运营、设计部门沟通协调，准备及发放样品

5.客户产品技术问题的支持

任职要求：

1. 电子类等相关专业，本科及硕士学历，微电子类专业优先

2. 熟悉常用测试设备使用方法及原理

3. 具有良好的沟通能力

4. 了解存储器的基本原理

5. 了解IC制造生产流程优先

**嵌入式软件/应用工程师（工作地：北京/西安/苏州）**

岗位职责：

负责32位MCU嵌入式内核开发与移植，硬件模块驱动设计和开发，上层应用编写和维护等工作。

任职要求：

1.计算机/电子工程/通信/自动化相关专业，硕士以上学历

2.具备扎实的计算机软件基础，精通C/C++程序设计，有Cotex-M3项目经验优先

3.熟悉ARM体系架构，嵌入式操作系统开发环境及流程

4.在校期间具备嵌入式项目应用软件开发经验者优先

5.有Windows驱动或应用程序开发项目经验优先

6. 诚信正直，踏实努力，具有较强的抗压能力

7. 具有良好的沟通能力、学习能力、分析能力和团队合作能力

**后端设计工程师（P&R）（工作地：北京/西安）**

岗位职责：

负责数字后端自动布局布线工作

任职要求：

1.微电子、电子工程相关专业，硕士以上学历

2.熟悉数字后端自动布局布线流程

3.有大规模数字IC项目经验

4.对低功耗设计有一定的了解

5.吃苦耐劳、有责任心和团队合作精神

6.有标准单元建库经验优先考虑

7.熟悉多电源域PR流程优先考虑

8.有65nm以下工艺经验优先考虑

**射频集成电路设计工程师（工作地：北京/西安/苏州）**

岗位职责:

负责射频模拟电路的设计和仿真

任职资格:

1、通信、微电子、微波及相关专业，硕士及以上学历

2、具有较好的RFIC设计、模拟IC设计基础，熟悉半导体器件、半导体物理的理论，熟悉IC设计流程和后端Layout设计流程

3、具有较强的学习能力、分析能力、沟通能力和较好的团队合作精神

4、良好的英语能力

5、有LNA、Mixer、PA、PLL等IC设计成功流片经验者优先

6、了解蓝牙/WIFI协议者优先

**无线网络物理层工程师（工作地点：苏州）**

岗位职责：

1. WiFi及其他无线通信协议的PHY层相关算法的设计、评估和优化

2. 链路级仿真平台的搭建和维护

3. 支持ASIC/FPGA验证，参与通信系统的联调和问题分析

任职要求：

1. 通信、电子等相关专业硕士

2. 熟悉无线通信与信号处理基本原理

3. 熟悉并了解通信系统算法开发的流程。

4. 以下为加分项：

 1）具备通信系统物理层算法设计及仿真的经验

 2）具备通信系统验证和联合调试的经验

 3）熟悉WiFi协议

 4）熟悉ASIC实现

**★ 网申地址：** job.gigadevice.com或将简历投递至weiwei.wu@gigadevice.com

**★ 每位应聘者只能投递投递1个职位哦~**